

## Market News

### **Double DPAK: Die erste SMD-Lösung mit Oberseitenkühlung für Hochleistungsanwendungen**

München, 4. Juni 2018 – Die zunehmende Komplexität der Endprodukte stellt hohe Anforderungen an die Designparameter von [Hochspannungsnetzteilen](#): Sie erfordern höhere Leistung und mehr Effizienz auf immer kleinerem Raum. Halbleiterbauelemente sind für die Funktion und Leistung moderner Schaltnetzteile (Switched Mode Power Supply, SMPS) unerlässlich. In den letzten Jahren geht der Trend dabei zu oberflächenmontierten Bauelementen (Surface Mount Device, SMD). Das Wärmemanagement der heutigen SMD-basierten SMPS-Designs ist dabei nach wie vor eine Herausforderung in puncto Effizienz. Infineon Technologies AG präsentiert jetzt Double DPAK (DDPAK) das erste SMD-Gehäuse mit Oberflächenkühlung, das speziell für Hochleistungsanwendungen wie Server, Telekommunikationsgeräte, [Solaranlagen](#) oder High-End-PC-Netzteile entwickelt wurde. Diese neue Gehäusetechnologie vereint schnelles Schalten und hohe Effizienz bei reduzierter Größe und Gewicht bei minimalen Gesamtbetriebskosten (TCO).

Das innovative, oberseitengekühlte Gehäuse übertrifft die Qualitätsanforderungen der Industrie. Das neuartige Konzept der Oberflächenkühlung setzt neue Maßstäbe am Markt für Hochleistungs-SMPS. Dabei werden die Funktionsmerkmale von DDPAK kombiniert mit den Vorzügen bereits existierender Hochspannungstechnologien wie [600V CoolMOS™ G7 SJ MOSFET](#) und [CoolSiC™ Schottky Diode 650V G6](#). Die thermische Entkopplung von Leiterplatte und Halbleiter ermöglicht eine höhere Leistungsdichte oder eine längere Systemlebensdauer.

DDPAK ist mit seinen branchenführenden Leistungsmerkmalen eine echte SMD-Alternative für Hochleistungs-SMPS-Designs. Das Gehäuse ist in 4-Pin Konfiguration, mit separatem „sense source“, ausgelegt, um dem Treiber ein ungestörtes Signal zu liefern. Dadurch ergibt sich ein höherer Wirkungsgrad bei Vollast.

Infineon liefert optimierte Systemlösungen für Hochleistungsdesigns durch die Kombination seines CoolMOS G7 mit den CoolSiC G6 und [EiceDRIVER™](#) Produktfamilien.

### **Verfügbarkeit**

Der 600V CoolMOS G7 SJ MOSFET und die CoolSiC Schottky Diode 650V G6 sind ab sofort mit DPAK-Package erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.infineon.com/smd-topsidecooling](http://www.infineon.com/smd-topsidecooling).

### **Infineon auf der PCIM 2018**

Auf der Fachmesse PCIM 2018 (Nürnberg, 5.-7. Juni 2018) zeigt Infineon zukunftsweisende Technologien für effiziente Systeme in Industrie-, Verbraucher- und Automobilanwendungen. Unter dem Motto „Empowering a world of unlimited energy“ werden die Demos von Infineon in Halle 9, Stand #412 ausgestellt. Weitere Informationen zu den Messe-Highlights von Infineon sind erhältlich unter: [www.infineon.com/PCIM](http://www.infineon.com/PCIM).

#### **Für die Fachpresse**

Informationsnummer INFPMM201806.057d

#### **Infineon Technologies AG**

Media Relations:

Volker Gieritz

Tel.: +49 89 234-36572

[volker.gieritz@infineon.com](mailto:volker.gieritz@infineon.com)

Investor Relations:

Tel.: +49 89 234-26655

[investor.relations@infineon.com](mailto:investor.relations@infineon.com)